

第30回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時：2020年10月16日(金) 13:40～17:00
オンライン開催

時間	題 目	講 演 者
	司会 高尾 尚史((株)豊田中央研究所)	
13:40～ 14:20	『硬く高性能な材料や素子を用いた柔らかく伸縮可能な電子デバイス』 (40分)	○岩瀬 英治(早稲田大学)
14:20～ 14:30	休 憩	
14:30～ 15:10	『カーエレクトロニクスの動向とパワーエレクトロニクス実装技術』 (40分)	○三宅 敏弘(車載エレクトロニクス実装研究所)
15:10～ 15:20	休 憩	
	司会 山中 公博(中京大学)	
15:20～ 16:00	『アルミニウム線材と基板材の超音波接合』 (40分)	○前田 将克(日本大学)
16:00～ 16:10	休 憩	
16:10～ 16:50	『銅微粒子の高濃度分散と電子部品部材への応用』 (40分)	○米澤 徹(北海道大学)
16:50～ 17:00	委 員 会 議 事	

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。